

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	2026年5月18日 Balyasny Asset Management、Greenwoods Asset Management、Point72、Polymer Capital、Barings LLC、FMR Investment Management 等
时间	2026年5月18日
调研方式	线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长、首席执行官、总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,700 多

	<p>个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。</p> <p>为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。</p> <p>基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。</p> <p>2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题： 请问公司认为未来业绩增长主要由哪些领域需求驱动？</p> <p>回复：近年来，随着人工智能技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的广泛应用，半导体产业迎来了高速增长期。AI ASIC 凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正成为市场增长的核心驱动力。</p> <p>2026 年初至 2026 年 4 月 29 日，公司新签订单金额 82.40 亿元，其中 AI 算力相关订单占比 91.37%，预计未来 AI 算力相关领域的客户需求</p>

将驱动公司业绩增长。

问题：请问公司量产业务主要和哪些晶圆厂合作？

回复：公司采用晶圆厂中立策略，和全球主流晶圆厂保持紧密联系并长期合作，供应链管理灵活且抗风险能力强，具体主要表现在：芯原对晶圆厂中立的策略，使得芯原可以和全球所有主流的晶圆厂合作，不受限于某一家公司的发展情况；公司与大多数晶圆厂拥有超过 10 年或 15 年的长期合作关系，共同发展，保持了良好的沟通；在长期合作中，芯原建立了良好的商业信誉，供应商会按历史合作数据预留产能，保障供给；公司可以通过打包的方式拿到产能，有自己的资源池，通过内部资源再分配，对中小型规模的客户友好；不同生产工艺的产能短缺时间和程度不一样，因芯原客户多样化，可以做一定的调整 and 平衡。

问题：请问公司如何看待未来端侧 AI 的发展？

回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

在端侧，我们积极布局智慧汽车、AR/VR 等增量市场，已经为多家国际行业巨头客户提供了技术和服 务。目前，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货近 2 亿颗，主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等 10 个市场领域，在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先，芯原的 NPU IP 已被 91 家客户用于上述市场领域的超过 140 款 AI 芯片中；在 AR/VR 眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AR/VR 客户正在

与芯原进行合作。

问题： 请问公司在 RISC-V 领域有哪些布局？

回复：公司以推动 RISC-V 生态发展为切入点，已积极布局 RISC-V 行业超过 7 年。2018 年 7 月上海市经信委发布国内首个和 RISC-V 相关的支持政策。2018 年 9 月，在上海市经信委支持下及上海集成电路行业协会推荐下，公司作为首任理事长单位，牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC）。目前，联盟会员单位已达到 204 家。由中国 RISC-V 产业联盟和芯原股份共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了 4 届，每届会议集中发布 10 余款来自不同本土企业的国产 RISC-V 芯片新品，现已累计推广了 40 多款。

目前，公司已与业内多家 RISC-V 领先企业达成合作。截至 2025 末，芯原的半导体 IP 已经获得 RISC-V 主要芯片供应商的 14 款芯片所采用；此外，芯原已为 25 家客户的 25 款 RISC-V 芯片提供了一站式芯片定制服务，上述项目正陆续进入量产。同时，公司还基于 RISC-V 核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感 SoC 等多个芯片设计平台，以及基于 RISC-V 核的硬件开发板，上述解决方案正逐步获得客户采用，将有助于推动 RISC-V 技术的商业化进程。